



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2012-0006301
(43) 공개일자 2012년01월18일

(51) Int. Cl.

H01R 33/76 (2006.01) G01R 31/26 (2006.01)

(21) 출원번호 10-2010-0066955

(22) 출원일자 2010년07월12일

심사청구일자 없음

(71) 출원인

삼성전자주식회사

경기도 수원시 영통구 삼성로 129 (매탄동)

(72) 발명자

김정훈

충청남도 아산시 배방읍 복수로 116, 108동 905호
(배방자이2 복수마을)

김용현

경기도 용인시 수지구 죽전로 267, 내대지 건영캐
스빌 801동 2102호 (죽전동)

(뒷면에 계속)

(74) 대리인

박영우

전체 청구항 수 : 총 10 항

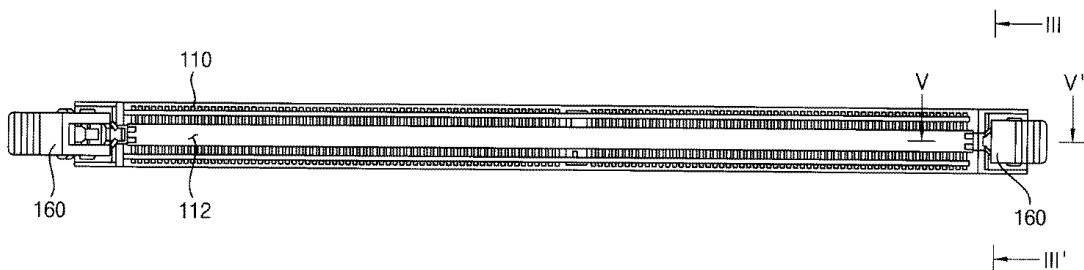
(54) 테스트 소켓

(57) 요약

테스트 소켓은 소켓 프레임, 플레이트, 소켓 핀 및 링크를 포함한다. 소켓 프레임은 피검체를 수용하는 슬롯을 갖는다. 플레이트는 상기 슬롯 내부에 상기 피검체의 진입 방향을 따라 이동 가능하게 배치되어, 상기 피검체의 하부면을 지지한다. 소켓 핀은 상기 슬롯의 측면에 상기 피검체의 진입 방향과 직교하는 방향을 따라 이동 가능하게 배치되어, 상기 피검체의 탭과 선택적으로 접촉한다. 링크는 상기 소켓 핀과 상기 플레이트 각각에 회전 가능하게 연결된다. 따라서, 피검체의 탭이 소켓 핀과 마찰 접촉하지 않게 되므로, 피검체의 탭이 파손되지 않게 된다.

대표도

100



(72) 발명자

한성찬

충청남도 천안시 동남구 용곡2길 43-11, 118동
1501호 (용곡동, 용곡 한라비발디)

유광수

충청남도 천안시 서북구 백석2길 12, 호반리젠시빌
103동 306호 (백석동)

황재선

충청남도 아산시 배방읍 배방로 131, 110동 103호
(한라비발디아파트)

특허청구의 범위

청구항 1

피검체를 수용하는 슬롯을 갖는 소켓 프레임(socket frame);

상기 슬롯 내부에 상기 피검체의 진입 방향을 따라 이동 가능하게 배치되어, 상기 피검체의 하부면을 지지하는 플레이트(plate);

상기 슬롯의 측면에 상기 피검체의 진입 방향과 직교하는 방향을 따라 이동 가능하게 배치되어, 상기 피검체의 탭과 선택적으로 접촉하는 소켓 핀(socket pin); 및

상기 소켓 핀과 상기 플레이트 각각에 회전 가능하게 연결된 링크(link)를 포함하는 테스트 소켓.

청구항 2

제 1 항에 있어서, 상기 소켓 핀을 지지하고 상기 링크가 회전 가능하게 연결된 소켓 블록을 더 포함하는 테스트 소켓.

청구항 3

제 2 항에 있어서, 상기 소켓 블록은 절연 물질을 포함하는 테스트 소켓.

청구항 4

제 1 항에 있어서, 상기 소켓 프레임에 회전 가능하게 연결되어, 상기 슬롯에 수용된 피검체의 이탈을 방지하는 랫치(latch)를 더 포함하는 테스트 소켓.

청구항 5

제 4 항에 있어서, 상기 랫치는 상기 플레이트에 연결되어, 상기 플레이트의 이동에 의해 회전되는 테스트 소켓.

청구항 6

제 5 항에 있어서, 상기 랫치는 상기 소켓 프레임의 양측부에 배치된 테스트 소켓.

청구항 7

제 1 항에 있어서, 상기 플레이트와 상기 슬롯의 저면 사이에 연결되어, 상기 플레이트를 상기 피검체의 진입 방향과 반대 방향을 향해 탄력 지지하는 스프링을 더 포함하는 테스트 소켓.

청구항 8

제 1 항에 있어서, 상기 플레이트는 절연 물질을 포함하는 테스트 소켓.

청구항 9

제 1 항에 있어서, 상기 링크는 상기 소켓 프레임의 양측부와 중앙부에 배치된 테스트 소켓.

청구항 10

피검체를 수용하는 슬롯을 갖는 소켓 프레임(socket frame);

상기 슬롯 내부에 상기 피검체의 진입 방향을 따라 이동 가능하게 배치되어, 상기 피검체의 하부면을 지지하는 플레이트(plate);

상기 슬롯의 측면에 상기 피검체의 진입 방향과 직교하는 방향을 따라 이동 가능하게 배치된 소켓 블록;

상기 소켓 블록에 고정되어, 상기 피검체의 탭과 선택적으로 접촉하는 소켓 핀(socket pin);

상기 소켓 블록과 상기 플레이트 각각에 회전 가능하게 연결된 링크(link);

상기 소켓 프레임에 회전 가능하게 연결되고, 상기 슬롯에 수용된 피검체의 이탈을 방지하는 제 1 단부와 상기 플레이트에 연결된 제 2 단부를 갖는 래치(latch); 및

상기 플레이트와 상기 슬롯의 저면 사이에 연결되어, 상기 플레이트를 상기 피검체의 진입 방향과 반대 방향을 향해 탄력 지지하는 스프링을 포함하는 테스트 소켓.

명세서

기술 분야

[0001] 본 발명은 테스트 소켓에 관한 것으로서, 보다 구체적으로는 메모리 모듈의 전기적 특성을 테스트하기 위한 소켓에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] CPU의 속도가 증가함에 따라, CPU를 포함하는 시스템의 성능을 향상시키기 위해 메인 메모리의 속도와 집적도를 증가시키기 위한 노력이 지속적으로 이루어지고 있다. 메인 메모리의 데이터 입출력 속도의 증가를 위해 CPU와 메모리 사이에는 고속의 패킷 송수신이 가능한 버스 구조가 채용되며, 메인 메모리의 기억 용량의 증가를 위해 인쇄회로기판(PCB) 상에 메모리를 탑재한 메모리 모듈이 사용되고 있다.

[0003] 메모리 모듈의 전기적 특성을 테스트하기 위해 소켓이 사용된다. 종래의 소켓은 소켓 프레임 및 탄성 소켓 핀을 포함한다. 소켓 프레임은 메모리 모듈을 수용하는 슬롯을 갖는다. 탄성 소켓 핀은 슬롯의 양측면에 배치된다. 메모리 모듈을 슬롯 내로 진입시키면, 메모리 모듈이 탄성 소켓 핀을 외측으로 밀게 된다. 즉, 메모리 모듈은 탄성 소켓 핀과 마찰 접촉한다. 메모리 모듈의 탭이 탄성 소켓 핀과 전기적으로 접촉한다.

[0004] 따라서, 메모리 모듈을 슬롯 내로 진입시키기 위해서는, 탄성 소켓 핀의 탄성력보다 강한 삽입력(insertion force)을 메모리 모듈이 인가할 것이 요구된다. 그러나, 삽입력으로 인해서 메모리 모듈의 탭에 스크래치(scratch), 파손, 들뜸, 쇼트 등과 같은 결함이 발생된다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0005] 본 발명은 피검체와 소켓 핀 간의 마찰 접촉 없이 전기적 특성 테스트를 수행할 수 있는 테스트 소켓을 제공한다.

과제의 해결 수단

[0006] 본 발명의 일 견지에 따른 테스트 소켓은 소켓 프레임, 플레이트, 소켓 핀 및 링크를 포함한다. 소켓 프레임은 피검체를 수용하는 슬롯을 갖는다. 플레이트는 상기 슬롯 내부에 상기 피검체의 진입 방향을 따라 이동 가능하게 배치되어, 상기 피검체의 하부면을 지지한다. 소켓 핀은 상기 슬롯의 측면에 상기 피검체의 진입 방향과 직교하는 방향을 따라 이동 가능하게 배치되어, 상기 피검체의 탭과 선택적으로 접촉한다. 링크는 상기 소켓 핀과 상기 플레이트 각각에 회전 가능하게 연결된다.

[0007] 본 발명의 일 실시예에 따르면, 테스트 소켓은 상기 소켓 핀을 지지하고 상기 링크가 회전 가능하게 연결된 소켓 블럭을 더 포함할 수 있다. 상기 소켓 블럭은 절연 물질을 포함할 수 있다.

[0008] 본 발명의 다른 실시예에 따르면, 테스트 소켓은 상기 소켓 프레임에 회전 가능하게 연결되어, 상기 슬롯에 수용된 피검체의 이탈을 방지하는 래치(latch)를 더 포함할 수 있다. 상기 래치는 상기 플레이트에 연결되어, 상기 플레이트의 이동에 의해 회전될 수 있다. 상기 래치는 상기 소켓 프레임의 양측부에 배치될 수 있다.

[0009] 본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 테스트 소켓은 상기 플레이트와 상기 슬롯의 저면 사이에 연결되어, 상기 플레이트를 상기 피검체의 진입 방향과 반대 방향을 향해 탄력 지지하는 스프링을 더 포함할 수 있다.

[0010] 본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 상기 플레이트는 절연 물질을 포함할 수 있다.

[0011] 본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 상기 링크는 상기 소켓 프레임의 양측부와 중앙부에 배치될 수 있다.

[0012] 본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 상기 피검체는 메모리 모듈을 포함할 수 있다.

- [0013] 본 발명의 다른 견지에 따른 테스트 소켓은 소켓 프레임, 플레이트, 소켓 블록, 소켓 핀, 링크, 랫치 및 스프링을 포함한다. 소켓 프레임은 피검체를 수용하는 슬롯을 갖는다. 플레이트는 상기 슬롯 내부에 상기 피검체의 진입 방향을 따라 이동 가능하게 배치되어, 상기 피검체의 하부면을 지지한다. 소켓 블록은 상기 슬롯의 측면에 상기 피검체의 진입 방향과 직교하는 방향을 따라 이동 가능하게 배치된다. 소켓 핀은 상기 소켓 블록에 고정되어, 상기 피검체의 탭과 선택적으로 접촉한다. 링크는 상기 소켓 블록과 상기 플레이트 각각에 회전 가능하게 연결된다. 랫치는 상기 소켓 프레임에 회전 가능하게 연결되고, 상기 슬롯에 수용된 피검체의 이탈을 방지하는 제 1 단부와 상기 플레이트에 연결된 제 2 단부를 갖는다. 스프링은 상기 플레이트와 상기 슬롯의 저면 사이에 연결되어, 상기 플레이트를 상기 피검체의 진입 방향과 반대 방향을 향해 탄력 지지한다.
- [0014] 본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 소켓 블록은 절연 물질을 포함할 수 있다.
- [0015] 본 발명의 다른 실시예에 따르면, 상기 랫치는 상기 소켓 프레임의 양측부에 배치될 수 있다.
- [0016] 본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 상기 플레이트는 절연 물질을 포함할 수 있다.
- [0017] 본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 상기 링크는 상기 소켓 프레임의 양측부와 중앙부에 배치될 수 있다.
- [0018] 본 발명의 또 다른 실시예에 따르면, 상기 피검체는 메모리 모듈을 포함할 수 있다.

발명의 효과

- [0019] 상기된 본 발명에 따르면, 피검체가 슬롯 내로 진입하여 플레이트를 누르게 되면, 플레이트에 링크를 매개로 연결된 소켓 핀이 슬롯 내부로 이동하여 피검체와 접촉하게 된다. 따라서, 피검체의 탭이 소켓 핀과 마찰 접촉하지 않게 되므로, 피검체의 탭이 파손되지 않게 된다.

도면의 간단한 설명

- [0020] 도 1은 본 발명의 실시예에 따른 테스트 소켓을 나타낸 평면도이다.
- 도 2는 도 1의 테스트 소켓을 나타낸 정면도이다.
- 도 3은 도 1의 III-III' 선을 따라 절단한 단면도이다.
- 도 4는 메모리 모듈이 슬롯 내에 진입된 상태를 나타낸 단면도이다.
- 도 5는 도 1의 V-V' 선을 따라 절단한 단면도이다.
- 도 6은 슬롯 내에 진입된 메모리 모듈을 랫치가 고정된 상태를 나타낸 단면도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0021] 이하, 첨부한 도면들을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예들을 상세히 설명한다.
- [0022] 본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 형태를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 본문에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 발명을 특정한 개시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 각 도면을 설명하면서 유사한 참조부호를 유사한 구성요소에 대해 사용하였다.
- [0023] 제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다.
- [0024] 본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
- [0025] 다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일

반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가지는 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.

- [0026] 도 1은 본 발명의 실시예에 따른 테스트 소켓을 나타낸 평면도이고, 도 2는 도 1의 테스트 소켓을 나타낸 정면도이며, 도 3은 도 1의 III-III' 선을 따라 절단한 단면도이고, 도 4는 메모리 모듈이 슬롯 내에 진입된 상태를 나타낸 단면도이며, 도 5는 도 1의 V-V' 선을 따라 절단한 단면도이고, 도 6은 슬롯 내에 진입된 메모리 모듈을 랫치가 고정된 상태를 나타낸 단면도이다.
- [0027] 도 1 내지 도 6을 참조하면, 본 실시예에 따른 테스트 소켓(100)은 소켓 프레임(110), 플레이트(120), 소켓 블럭(130), 소켓 핀(140), 링크(150), 랫치(160) 및 스프링(170)을 포함한다.
- [0028] 소켓 프레임(110)은 피검체를 수용하는 슬롯(112)을 갖는다. 본 실시예에서, 피검체는 메모리 모듈을 포함할 수 있다. 메모리 모듈은 SIMM(Single In-lined Memory Module)과 DIMM(Dual In-lined Memory Module)로 포함할 수 있다. SIMM은 인쇄회로기판(Printed Circuit Board:PCB)의 한쪽면에만 반도체 패키지들을 탑재한 것이며, DIMM은 PCB의 양쪽면 모두에 반도체 패키지들을 탑재한 것이다.
- [0029] 메모리 모듈이 얇은 플레이트 형상을 가지므로, 소켓 프레임(110)은 대략 긴 직육면체 형상을 갖는다. 슬롯(112)은 소켓 프레임(110)의 상부면 전체에 걸쳐 형성된다.
- [0030] 플레이트(120)는 슬롯(112)의 내부에 배치되어, 슬롯(112) 내로 진입한 메모리 모듈을 지지한다. 즉, 플레이트(120)의 상부면이 메모리 모듈의 하부면과 접촉한다. 본 실시예에서, 플레이트(120)는 슬롯(112) 내부에 메모리 모듈의 진입 방향, 즉 수직 방향을 따라 이동 가능하게 배치된다. 예를 들면, 플레이트(120)는 소켓 프레임(110)에 수직 가이드(미도시)를 매개로 연결될 수 있다. 또한, 플레이트(120)가 메모리 모듈을 견고하게 지지하도록 하기 위해서, 플레이트(120)는 메모리 모듈의 하부면 전체와 접촉할 수 있다. 따라서, 플레이트(120)는 슬롯(112)의 면적과 유사한 면적을 가질 수 있다. 또는, 플레이트(120)는 메모리 모듈을 부분적으로 지지하는 복수개일 수도 있다. 한편, 테스트 전류가 플레이트(120)로 흐르지 않도록 하기 위해서, 플레이트(120)는 절연 물질을 포함할 수 있다.
- [0031] 소켓 블럭(130)은 슬롯(112)의 양측부에 배치된다. 메모리 모듈의 탭이 메모리 모듈의 양측면에 배치되므로, 탭과 대응하도록 소켓 블럭(130)은 슬롯(112)의 양측부에 배치된 한 쌍으로 이루어진다. 본 실시예에서, 소켓 블럭(130)은 메모리 모듈의 진입 방향과 실질적으로 직교하는 방향, 즉 수평 방향을 따라 이동 가능하게 슬롯(112) 내에 배치된다. 예를 들면, 소켓 블럭(130)은 소켓 프레임(110)에 수평 가이드(미도시)를 매개로 이동 가능하게 연결될 수 있다. 한편, 테스트 전류가 소켓 블럭(130)으로 흐르지 않도록 하기 위해서, 소켓 블럭(130)은 절연 물질을 포함할 수 있다.
- [0032] 소켓 핀(140)이 소켓 블럭(130)에 고정된다. 따라서, 소켓 블럭(130)의 이동에 의해 소켓 핀(140)도 같이 이동된다. 소켓 핀(140)은 메모리 모듈의 탭과 전기적으로 접촉하여, 테스트 전류가 소켓 핀(140)을 통해서 메모리 모듈의 탭으로 공급된다. 따라서, 소켓 핀(140)은 메모리 모듈의 탭과 동일한 수로 이루어진다.
- [0033] 링크(150)는 소켓 블럭(130)과 플레이트(120)를 연결하여, 플레이트(120)와 소켓 블럭(120)을 연동시킨다. 소켓 블럭(130)이 한 쌍이므로, 링크(150)도 2개의 소켓 블럭(130)들과 하나의 플레이트(120)를 연결시키는 한 쌍으로 이루어진다. 본 실시예에서, 링크(150)는 힌지핀(152, 154)들을 매개로 소켓 블럭(130)과 플레이트(120) 각각에 회전 가능하게 연결된다. 따라서, 플레이트(120)의 수직 운동은 링크(150)를 통해 소켓 블럭(130)으로 전달되어, 소켓 블럭(130)이 수평 방향을 따라 이동됨으로써, 소켓 핀(140)이 메모리 모듈의 탭에 선택적으로 접촉한다.
- [0034] 본 실시예에서, 링크(150)는 소켓 프레임(110)의 양측부에 배치되어, 플레이트(120)의 양측부를 지지할 수 있다. 부가적으로, 메모리 모듈이 안치된 플레이트(120)의 중앙부가 처지는 것을 방지하기 위해, 링크(150)는 소켓 프레임(110)의 중앙부에도 배치될 수 있다.
- [0035] 랫치(160)는 소켓 프레임(110)에 힌지핀(166)을 매개로 회전 가능하게 연결된다. 랫치(160)는 슬롯(112) 내로 진입한 메모리 모듈의 이탈을 방지한다. 본 실시예에서, 랫치(160)는 메모리 모듈에 형성된 걸림홈에 삽입되는 제 1 단부(162), 및 플레이트(120)의 하부면과 접촉하는 제 2 단부(164)를 갖는다. 메모리 모듈이 플레이트(120)를 누르게 되어 플레이트(120)가 하강하게 되면, 제 2 단부(164)가 힌지핀(166)을 중심으로 회전하게 된다. 따라서, 제 1 단부(162)가 메모리 모듈의 걸림홈으로 진입하게 되어, 메모리 모듈이 상방으로 이동하는 것을 방지한다. 본 실시예에서, 랫치(160)는 메모리 모듈의 양측부를 고정하도록, 소켓 프레임(110)의 양측부에

배치될 수 있다.

- [0036] 스프링(170)은 플레이트(120)와 소켓 프레임(110)의 저면 사이에 연결되어, 플레이트(120)를 상부를 향해서 탄력 지지한다. 즉, 랫치(160)의 제 1 단부(162)를 메모리 모듈의 걸림홈으로부터 이탈시키면, 스프링(170)의 복원력에 의해 플레이트(120)와 메모리 모듈이 상부로 쉽게 이동될 수 있다.
- [0037] 도 5를 참조하면, 메모리 모듈이 슬롯(112) 내로 진입하기 전에는, 랫치(160)의 상단이 외측으로 벌어져서, 슬롯(112)이 개방된 상태이다. 또한, 도 3에 도시된 바와 같이, 소켓 블럭(130)과 소켓 핀(140)도 외측 방향으로 이동된 상태이다. 따라서, 슬롯(112) 내부에는 메모리 모듈의 진입을 방해하는 어떠한 구조물도 존재하지 않는다.
- [0038] 도 4를 참조하면, 메모리 모듈을 슬롯(112) 내로 진입시키면, 스프링(170)을 압축시키면서 메모리 모듈의 하부면과 접촉하고 있는 플레이트(120)가 하강한다. 플레이트(120)의 하강은 한 쌍의 링크(150)의 상단들을 슬롯(112) 안쪽으로 이동시키게 된다. 따라서, 한 쌍의 소켓 블럭(130)들이 슬롯(112) 안쪽으로 이동됨으로써, 소켓 핀(140)이 슬롯(112) 내에 이미 진입한 메모리 모듈의 탭에 접촉하게 된다. 이와 같이, 메모리 모듈의 슬롯(112) 내로 진입한 후 소켓 핀(140)이 메모리 모듈의 탭과 접촉하게 되므로, 탭과 소켓 핀(140) 간에 마찰 접촉이 발생되지 않는다. 결과적으로, 스크래치(scratch), 파손, 들뜸, 쇼트 등과 같은 결함이 탭에 발생하는 현상이 근원적으로 방지된다.
- [0039] 한편, 도 6에 도시된 바와 같이, 플레이트(120)의 하강과 함께 랫치(160)가 힌지핀(166)을 매개로 회전하게 된다. 따라서, 랫치(160)의 제 1 단부(162)가 메모리 모듈의 걸림홈에 삽입되어, 테스트 동작 중에 메모리 모듈이 슬롯(112)으로부터 이탈되지 않게 된다.
- [0040] 메모리 모듈의 테스트가 완료되면, 랫치(160)의 제 1 단부(162)를 메모리 모듈의 걸림홈으로부터 이탈시킨다. 그러면, 스프링(170)의 복원력에 의해서 플레이트(120)가 메모리 모듈과 함께 상승하게 되어, 슬롯(112)으로부터 메모리 모듈이 이탈된다. 이와 동시에, 플레이트(120)의 상승은 링크(150)의 상단을 슬롯(112)의 외측으로 이동시키게 되므로, 소켓 블럭(130)과 소켓 핀(140)도 슬롯(112)의 외측으로 이동된다. 따라서, 메모리 모듈의 상승과 동시에 탭과 소켓 핀(140) 간의 접촉이 해제되므로, 탭과 소켓 핀(140) 간에 마찰 접촉이 발생되지 않는다.
- [0041] 여기서, 본 실시예에서는 피검체로서 메모리 모듈을 예로 들어 설명하였으나, 전기적 특성 검사가 요구되는 다른 피검체도 본 발명의 테스트 소켓에 적용할 수 있을 것이다.
- [0042] 상술한 바와 같이 본 발명에 의하면, 슬롯 내로 진입하거나 슬롯으로부터 이탈되는 피검체와 소켓 핀 간에 마찰 접촉이 발생되지 않는다. 따라서, 피검체의 탭이 파손되지 않게 된다.
- [0043] 상술한 바와 같이, 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만 해당 기술 분야의 숙련된 당업자라면 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

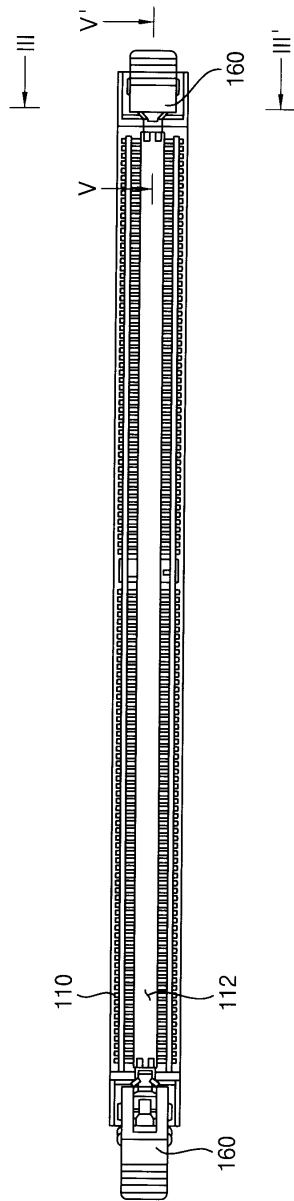
부호의 설명

- [0044]
- | | |
|-------------|------------|
| 110 ; 소켓 몸체 | 120 ; 플레이트 |
| 130 ; 소켓 블럭 | 140 ; 소켓 핀 |
| 150 ; 링크 | 160 ; 랫치 |
| 170 ; 스프링 | |

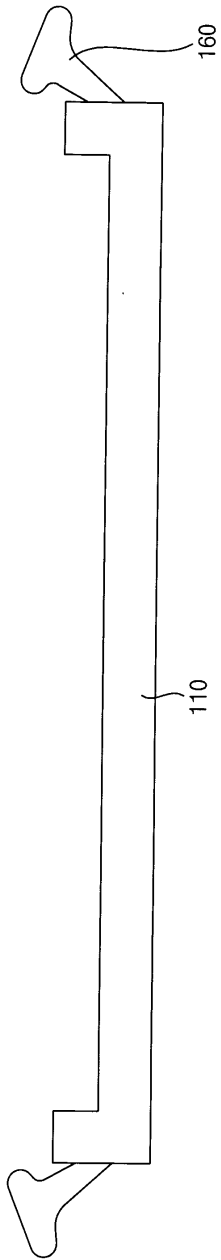
도면

도면1

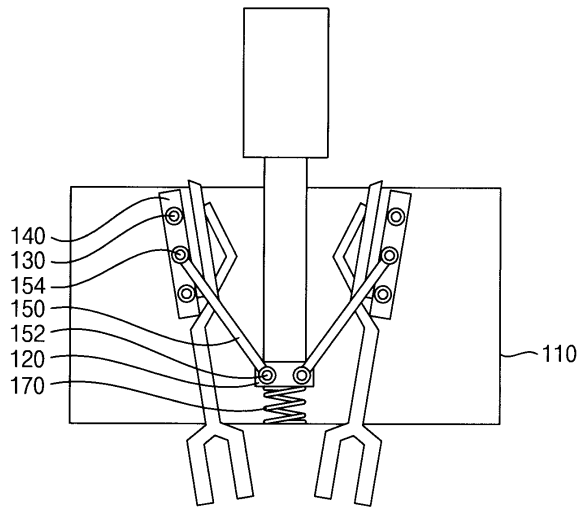
100



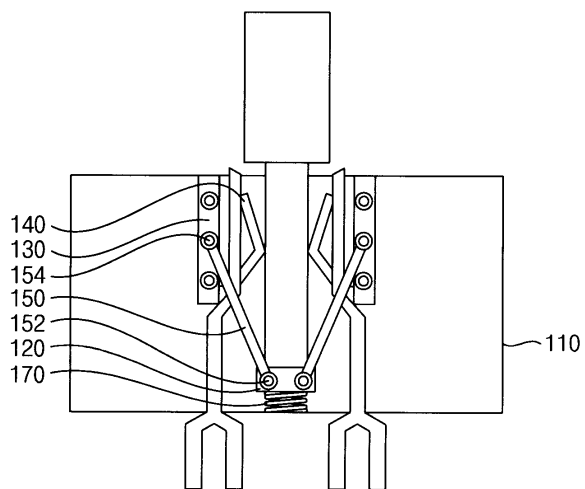
도면2



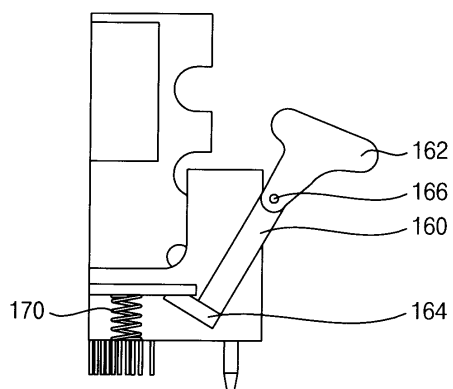
도면3



도면4



도면5



도면6

